

Einladung



**Schweizerische Gesellschaft
für Oberflächentechnik
Société Suisse de Traitement
de Surface**

ZUM TRADITIONELLEN SGO- LEITERPLATTENSEMINAR

Wir freuen uns sehr, Sie zum diesjährigen traditionellen SGO Leiterplattenseminar einzuladen. Ein abwechslungsreicher Nachmittag mit spannenden Vorträgen zu aktuellen Themen erwartet Sie.

Im Namen des OK's wünschen wir allen Beteiligten eine interessante und spannende Veranstaltung mit vielen Kontakten und wertvollen Anregungen im Kreise der Schweizerischen und Süddeutschen Leiterplatten-Familie.

Datum: Mittwoch, 27. September 2023

Beginn: 13:30h

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus
im Spilhöfler
CH-8142 Uitikon ZH
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Kosten: Mitglieder CHF 80.00
Nichtmitglieder CHF 125.00

Zahlung mit Bargeld vor Ort oder Vorkasse

Bankverbindung für Vorkasse:

Bâloise Bank SoBa AG, Centralstr. 8, CH-2540 Grenchen

IBAN / Kontonummer: CH91 0833 4000 0S23 3695 A

Clearing: 8334 / Swift-Code: kbsoch22

Zu Gunsten von: SGO, Rebgrasse 14, CH-2540 Grenchen

Im Preis inbegriffen sind Kaffee, Apéro + Nachtessen (ohne Getränke)

Anmeldung: www.sgo-sst.ch – Fachanlässe

bis spätestens: 8. September 2023

Programm

- 13:30 Uhr **Begrüßung**
Romeo Premerlani, Market Development Manager bei Varioprint AG, CH-9410 Heiden
- Marktanalyse Europa (speziell D / A / CH)**
Remo Fischer, Betriebsleitung Hofstetter PCB AG, CH-6403 Küssnacht
- 13:45 Uhr **Leiterplatten für GHz-Anwendungen – das neue Delta-L 4.0**
Messverfahren zur Materialqualifizierung
Hermann Reischer, Vertriebsleitung,
Polar Instruments GmbH, AT-4865 Nussdorf
- Immer anspruchsvollere Designs und Übertragungsfrequenzen im GHz-Bereich fordern die exakte Kenntnis der LP-Materialeigenschaften. Ab ca. 4 GHz wird eine Leiterbahn als verlustbehaftet betrachtet und die dielektrischen Verluste sowie die Kupferrauheit haben wesentlichen Einfluss auf die Dämpfung und Signalintegrität. Mit der neuen Delta-L 4.0 Messmethode steht der Leiterplattenindustrie erstmals ein produktionstaugliches Prüfmittel zur Verfügung, um Materialien bis 43 GHz oder 70 GHz zu qualifizieren.
- 14:30 Uhr **mSAP**
Thomas Pliet R&D PCB and Electronics Project Manager,
Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG., DE-73312 Geislingen/Steige
- Nicht nur im 5G Sektor, auch im Bereich Automotive und Medizinaltechnik steigen die Anforderung an die Leiterplatten ständig.
- KI und Autonomes Fahren und die dabei notwendigen Regelsysteme erhöhen nicht nur die benötigte Anzahl an Leiterplatten, sondern fordern auch immer höhere Integrationsdichten wie auch bessere Signalübertragung und ein verbessertes Wärmemanagement.
- Mittels mSAP können die neuen Anforderungen erfüllt werden, stellen aber für die galvanotechnischen Beschichtungen neue Herausforderungen dar.
- Mit dem universell einsetzbaren Kupferelektrolyt SLOTOCOUP SF 50 können Innenlagen, Aufbau und Außenlagen beschichtet werden. Hierdurch wird eine 3 in 1 Lösung zur Fertigung von mSAP Leiterplatten angeboten, welche die galvanische Kupferabscheidung optimiert und effizienter gestaltet.
- 15:15 Uhr **Dickschicht PCB**
Gaya Hortense, Head of Thick film technology & printed electronics business unit, Chimie Tech Services part of CCI Eurolam group
- Hortense Gaya leitet das Printed Electronics und Dickschichtpasten Business bei der CCI Eurolam Group. Mit Ihrem Team unterschützt sie die flexiblen

und dehnbaren Leiterplatten-Projekte, bei denen leitfähige Pasten auf Substrate aus PET, PI oder TPU gedruckt werden.

Seit Covid beziehen sich mehr und mehr Projekte auf medizinische E-Patches, die bequem und leicht sein sollen. Die Präsentation wird die Kombination aus der Dupont Liveo „soft electrode“ und dem Micromax Intexar dehnbaren Pastensystem für die 14-Tage Überwachung von Patienten vorstellen.

16:00 Uhr ***Pause***

16:30 Uhr ***Additive Fertigung von Elektronik (AME) - Status, Perspektiven und Anwendungen***

Valentin Storz, General Manager von Nano Dimension EMEA,
Nano Dimension GmbH, DE-80807 München

Bei der additiven Fertigung von Elektronik werden elektronische Bauteile und Schaltungen durch schichtweises Auftragen von Materialien wie Leiterbahnen, Lötstellen und elektronischen Komponenten produziert. Dieses Verfahren ermöglicht eine saubere, schnelle, flexible und effiziente Herstellung von Elektronikbauteilen im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsmethoden.

Die Anwendungen der AME-Technologie sind vielfältig und reichen von der Prototypen- und Einzelstückherstellung bis hin zur Produktion von Serienprodukten. Sie umfassen die Herstellung von Sensoren, Antennen, gedruckten 3D-Schaltkreisen, Wearables, medizinischen Geräten, Robotern und elektronischen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt.

In den letzten beiden Jahren hat sich die AME-Technologie rasant weiterentwickelt. Valentin Storz gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Technologie, Einblicke in Kundenanwendungen und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.

17:15 Uhr ***Innovative Dünnschicht-Schutzschichten für die Elektronik auf der Basis von Parylen***

Andreas Hogg, Gründer und CEO, COAT-X, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Die innovative Verkapselungstechnologie von Coat-X bietet eine hochwertige Lösung in Form einer dünnen (< 10 µm), biokompatiblen und mehrschichtigen Beschichtung zum Schutz kritischer Komponenten wie PCBs, Sensoren, MEMS-Strukturen, Magneten und anderen.

Ziel der Technologie ist es, die herkömmliche Metall- oder Glaskapselung durch eine Dünnschichtbeschichtung aus Parylene und Keramik im Nanometerbereich zu ersetzen, um die Geräte weiter zu miniaturisieren und die Kosten zu senken.

18:00 Uhr ***Schlusswort***

18:05 Uhr ***Apéro mit anschließendem Nachtessen***
und gemütlichem Beisammensein